

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-16

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名(排名不分先后)	中欧基金、华创证券、东吴证券、易方达基金
时间	2021年9月28日-9月30日
地点	公司龙岗总部1楼会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：谢丹。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司 PCB 业务各领域营收占比情况。</p> <p>公司 PCB 业务营收以通信领域为主，数据中心、汽车电子领域营收占比持续提升，工控医疗领域保持稳定发展。</p> <p>Q2、请介绍公司 PCB 业务当前产能利用率情况。</p> <p>随着通信市场需求逐步回暖，同时公司大力开发数据中心、汽车电子、工控医疗等市场，公司 PCB 产能利用率自 2021 年初以来持续恢复。目前 PCB 产能利用率较 2021 年上半年有所改善。</p> <p>Q3、请介绍公司对 5G 通信市场的后续展望。</p> <p>2020 年 8 月中下旬后，受外部环境影响，通信行业整体需求在短期内有所调整。近</p>

期，国内和海外通信市场逐步呈现回暖趋势。从长期来看，伴随 5G 在增强移动宽带、低延时高可靠通信、海量机器类通信场景中各类应用的不断发展，5G 通信市场仍存在广泛的需求。公司深耕通信领域多年，对通信市场的前景保持信心。

Q4、请介绍公司对数据中心市场的后续展望。

数据中心作为公司近年来新进入并重点拓展的领域之一，已对公司营收产生较大贡献，整体市场空间有待公司进一步开拓。伴随 5G 时代对信息传输速度及传输容量的需求提升，数据中心硬件也持续向高速、大容量的方向发展，其对 PCB 在高速材料应用、加工密度及设计层数方面都有着更高要求，会推动产品价值量的提升。公司将凭借已有的管理优势和技术优势，继续加大对数据中心市场的拓展力度，与更多的客户建立并加深合作关系。

Q5、请介绍公司通信类 PCB 主要产品类型。

公司生产包括应用于无线网、传输网、数据通信、固网宽带领域主要设备的相关 PCB 产品，如背板、高速多层板、高频微波板、多功能金属基板等，根据不同的产品应用需求，具备相应的高速材料应用、大尺寸、高多层、HDI、刚挠结合等特性。

Q6、请介绍公司汽车电子业务主要产品类型。

公司汽车电子业务主要聚焦 ADAS 和新能源汽车方向，提供包括用于大功率散热、高速高频和集成小型化解决方案的各类汽车电子 PCB 产品。

Q7、请介绍封装基板市场前景与竞争格局。

随着国内集成电路产业的不断发展，我国在封测领域已取得一定进步，但与之配套的封装基板尚处于起步阶段，国内目前尚无规模较大的封装基板企业。在国内集成电路产业快速发展的环境下，封装基板产业存在广阔的市场机会。另一方面，由于封装基板直接与芯片相连，产品尺寸较小、精密度较高，在线路精细、孔距大小和信号抗干扰等方面要求较高，因此需要精密的层间对位技术、电镀能力和钻孔技术等，存在较高的技术壁垒。公司于 2009 年正式进入封装基板领域，现已具备较完善的精细线路产品技术能力以及质量能力平台，在国内拥有进入该领域的先发优势，在部分细分市场上具有领先

	<p>的竞争优势。</p> <p>注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2021年9月30日